LAGENAUFBAU HDI (Standard)

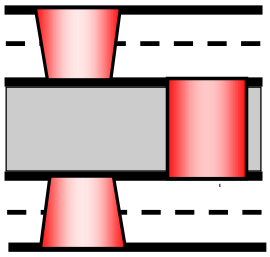
HDI04_1+2b+1_0,80

4 - Lagen

Kern: 0,61 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 2B + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1			12 µm		**35**	
			0,610 mm			**610**	
3	RSK1			12 µm		**35**	
					1 x 1080	**60**	
4	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material:				824	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**0,80**	+/-	0,08	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	0,88	+/-	0,10	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	0,94	+/-	0,12	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
04.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.01.2006	R. Schönholz	00	8-